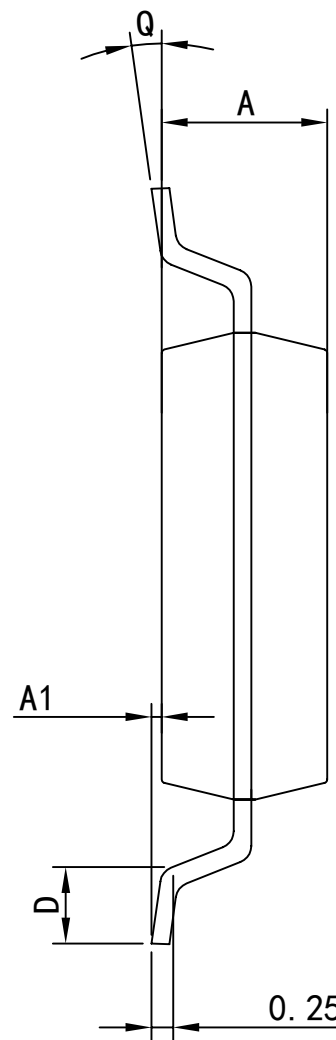
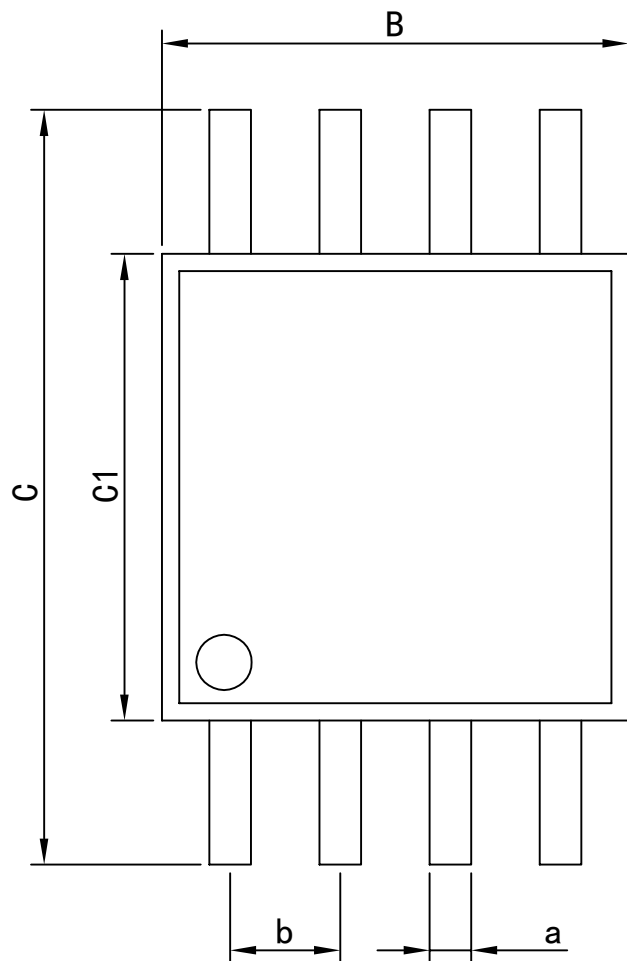




华冠半导体

广东华冠半导体有限公司

Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.



制图	赖谊成
审阅	罗云龙
核准	林钟涛

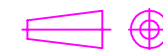
SOP8 (208MIL)

文件名称:
HG-SOP8 (208MIL)

文件编号:
HGWT-230030

版本	VI.0
比例	1:1
单位	mm
日期	2023-6-29

图纸幅面 A4



第一角法

UNITT : mm

DIM.	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b			
MIN	1.70	0.05	5.18	7.70	5.18	0.50	0°	0.35	1.27			
MAX	1.91	0.25	5.38	8.70	5.38	0.80	8°	0.48	BSC			